

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划 激励对象名单的公告情况说明及核查意见

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2026-018 无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2026年限制性股票激励计划 激励对象名单的公告情况说明及核查意见

激励计划(草案)及其摘要的议案等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》以下简称《管理 办法》)的相关规定,公司于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公告(以下简称“公告”) 中,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关情况如下:

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》以下简称《管理 办法》)的相关规定,公司于2026年限制性股票 激励计划(草案)及其摘要的议案等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》以下简称《管理 办法》)的相关规定,公司于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公告(以下简称“公告”) 中,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关情况如下:

(6)中国证监会认定的其他情形。 3、列入失信被执行人名单、失信被执行人名单(以下简称“失信名单”)的人员(根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》(以下简称“失信名单”)等法律法规和规范性文件的规定);

苏州近岸白质科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码:688137 证券简称:近岸白质 公告编号:2026-025 苏州近岸白质科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

46.25万股(含),回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸白质科技股份有限公司关于回购公司股份价格上限 的公告》(公告编号:2026-008)。

1、本次回购的总金额为2026年10月10日15时收市后的股本结构,本次回购股份总数情况 为2026年4月13日(即本次回购实施完成日)15时收市后的股本结构。

遂空公司指定网址:https://www.protopin.com.cn,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。

新大洲控股股份有限公司 股票交易异动公告

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2026-038 新大洲控股股份有限公司 股票交易异动公告

三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息。

司)及控股子公司累计12个月发生的新增诉讼案件共计4件,涉案金额总计为人民币470.86万元,占 公司最近一期经审计净资产的11.14%。新增诉讼案件情况如下表:

Table with 6 columns: 序号, 诉讼标的/案由, 被告, 诉讼请求, 涉案金额(单位:人民币元), 诉讼进展. Row 1: 被告: 德意志银行, 诉讼请求: 原告请求判令被告支付违约金...

天津海通半导体设备股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计 额度的公告

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-046 天津海通半导体设备股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计 额度的公告

三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息。

2021年10月22日 前通浦通安路228号11幢 南通海通超微电子有限公司 研发、生产、销售集成电路等产品,并提供集成电路技术服务;自营和代理上述 产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。 天津海通半导体设备股份有限公司 董事会 2026年6月24日

天津海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-045 天津海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息。

天津海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议于2026 年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件、 电话、短信等方式送达全体董事。本次会议出席董事6人,实际出席董事6人,通讯方式出席董事 6人。

特此公告。 天津海通半导体设备股份有限公司 董事会 2026年6月24日

天津海通半导体设备股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的 公告

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-047 天津海通半导体设备股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的 公告

三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息。

为更好对接公司发展规划和战略实施的需要,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的 各级子公司)拟在上展已披露过的综合授信额度的基础上,增加不超过等值人民币8亿元(含8亿 元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林特货币)的综合授信额度(最终以实际审批的授信额 度为准)。

特此公告。 天津海通半导体设备股份有限公司 董事会 2026年6月24日

天津海通半导体设备股份有限公司 关于增加日常关联交易预计 额度的公告

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2026-048 天津海通半导体设备股份有限公司 关于增加日常关联交易预计 额度的公告

三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息。

为更好对接公司发展规划和战略实施的需要,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的 各级子公司)拟在上展已披露过的综合授信额度的基础上,增加不超过等值人民币8亿元(含8亿 元,实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林特货币)的综合授信额度(最终以实际审批的授信额 度为准)。

特此公告。 天津海通半导体设备股份有限公司 董事会 2026年6月24日